



Crème à braser DP 5600

INTERFLUX®
ELECTRONICS N.V.



Fiche technique DP 5600

Ver: 3.11 30-09-15

Page 1

Crème à braser à basse température, sans nettoyage, sans halogènes et sans plomb

Description

La crème à braser **DP 5600** est sans nettoyage et sans halogènes avec un alliage à basse température SnBi (Ag).

La crème est utilisée typiquement pour braser des composants avec une grande sensibilité à des températures élevées, comme par exemple les Leds, les Elcos, les composants qui sont composés de matière plastique,... Une autre application est le brasage des blindages.

La crème à braser **DP 5600** présente une bonne brasabilité et des joints de brasure propres sans les résidus typiquement noirs.

Elle combine une formation limitée de "voids" avec une grande stabilité en sérigraphie.

La crème à braser **DP 5600** est absolument sans halogènes, elle garantit une très grande fiabilité après refusion.

Les résidus après refusion sont minimums et clairs.

La crème à braser **DP5600** est classée **RO LO** suivant les normes IPC et EN.



La photo n'est pas contractuelle



RoHS
compliant

Informations:

<i>Profil de refusion</i>	<i>P. 2</i>
<i>Recommandations pour le profil</i>	<i>P. 2</i>
<i>Manipulation</i>	<i>P. 3</i>
<i>Résultats des tests</i>	<i>P. 3</i>
<i>Recommandations pour les paramètres</i>	<i>P. 4</i>

Avantages:

- Grande stabilité en sérigraphie
- Bonne brasabilité sur de nombreuses finitions
- Joints de brasure propres sans les résidus typiquement noirs
- Formation limitée de "voids"
- Faibles résidus après refusion
- Absolument sans halogènes

Disponibilité

alliages	% de partie métallique	température de fusion	granulométrie	conditionnement
Sn42Bi57Ag1	sérigraphie: 90% dispensing: 87%	139°C	standard type 3 (25— 45µ)	pot :250g/500g cartouche: 6Oz: 500g/600g/700g 12Oz: 1kg/1,2kg/1,3kg/1,5kg seringue: 5CC/10CC/30CC autres conditionnements sur demande
autres alliages sur demande			autres types sur demande	



Profil de refusion

Description Générale

En général un profil de refusion linéaire ou avec un palier limité est recommandé. Des profils avec un palier sont également possibles et peuvent être utilisés afin de limiter les différences de températures du circuit surtout sur des cartes

possédant une grande diversité de composants. La température de fusion basse limite fortement le risque de surchauffage. Cependant, quand vous brasez une carte avec un four à refusion faites attention à ne pas surchauffer les compo-

sants, en particulier quand vous utilisez de la convection ou de l'infrarouge. Il est important de connaître les limites de températures de vos composants. Pour avoir une bonne appréciation de l'état thermique de votre carte, contrôlez votre

profil de refusion avec des thermocouples. Mesurez sur des grands, des petits et des composants critiques en températures situés sur les côtés, au milieu et à proximité des gros composants.

Recommandations pour le profil de refusion—alliages SnBi(Ag)

Préchauffage

De la température ambiante jusqu'à 120° une pente de 1 – 3°C/secondes est conseillée. Des montées en températures plus rapides peuvent détruire des composants en raison de l'humidité absorbée par ceux-ci.

Palier

Généralement entre 100°C et 120°C on maintient la température

entre 0°C/s et 1°C/s afin de rendre homogènes les différences de températures de la carte. C'est souvent utilisé pour des cartes à grandes dispersions thermique.

Monter à la zone de refusion

Maximum 4°C/s en raison de la dilatation thermique des matériaux qui composent une carte électronique.

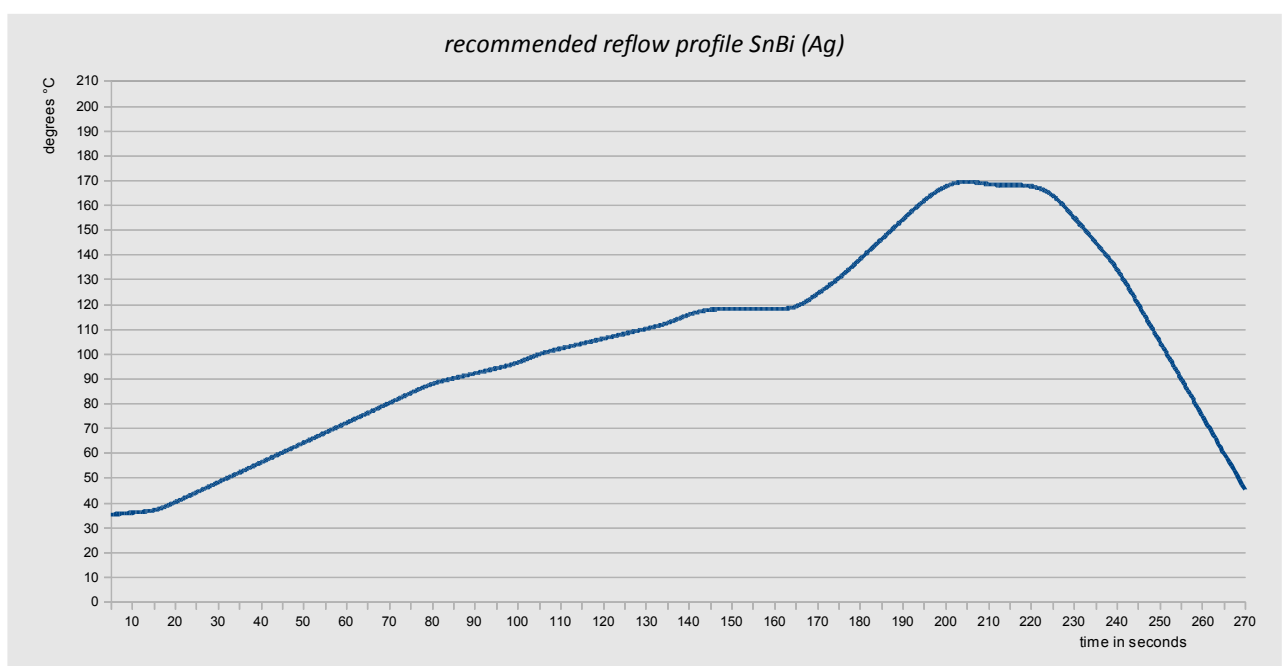
Refusion

Le pic de refusion est en relation avec le point de fusion de l'alliage utilisé. En général entre 160°C et 190°C. Le temps de refusion (Au-dessus du point de fusion de l'alliage utilisé) doit être entre 30 secondes et 90 secondes. Les cartes en finition NiAu peuvent requérir une température du pic de refusion plus élevé afin d'obtenir une

meilleure cosmétique des joints brasés.

Refroidissement

Environ - 4°C/s en raison du coefficient de dilatation thermique des composants.





Manipulation

Stockage

Stocker la crème à braser dans les pots hermétiques d'origines à environ 3° - 7°C.
Durée de vie : 6 mois

Manipulation

S'assurer que la crème soit à température ambiante dans le pot fermé pour éviter la condensation de l'eau. Mélanger avant toute utilisation.

Sérigraphie

Assurer une bonne étanchéité entre la carte et le pochoir. N'appliquer pas plus de pression sur les racles que nécessaire, le pochoir après la sérigraphie doit être propre. Appliquer suffisamment de crème à braser sur le pochoir afin que la crème puisse rouler aisément pendant la sérigraphie. Rajouter de la

crème à intervalle régulier.

Entretien

Un nettoyage régulier sous le pochoir est recommandé afin d'assurer une bonne qualité de sérigraphie. Le produit de nettoyage **ISC8020** est recommandé en lingettes ou en forme liquide.

Réutiliser la crème

Ne pas mélanger de la crème fraîche avec de la crème déjà utilisée. Ne pas remettre de la crème déjà utilisée dans le réfrigérateur. Remettre l'opercule et fermer le pot avec le couvercle à l'abri de l'humidité. Faites un test de sérigraphie avant toute utilisation en production.

Résultats des tests de fiabilité

Conforme à la norme IPC J-STD-004A/J-STD-005

Propriétés	Résultats	Méthodes
Chimique		
Miroir de cuivre	passé	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.32
Quantité d'halogènes	0,0%	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.28.1
Argent chromate (Cl, Br)	passé	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.33
Classification du flux	RO LO	J-STD-004A
Environnement		
Test SIR	passé	J-STD-004A IPC-TM-650 2.6.3.3

Propriétés	Résultats	Méthodes
Mécanique		
Test de microbilles	après 15min passé	J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.43
	après 4h passé	J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.43
Test de mouillage	passé	J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.45
Test d'effondrement	15min à 25°C passé	J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.35
	après 15min à 120° passé	IF SLMP SnBi(Ag)



Recommandations et paramètres d'utilisation

Vitesse de sérigraphie:	25—100 mm/sec
Pression des racles:	250g—350g/cm
Nettoyage:	toutes les 10 cartes
Température:	15°C à 25°C
Pose des composants	
"Tack time" (23°C et 50% H.R.):	>8 heures
Refusion	
Profil de refusion:	linéaire ou avec palier
Type de chauffe:	convection, phase vapeur, ...
Résidus après refusion:	5% w/w

Nom commercial du produit : DP 5600 No-Clean, Lead Free Solder Paste

CLAUSE

Du fait qu'Interflux® Electronics N.V. ne peut pas prévoir ou contrôler les différentes conditions dans lesquelles ces informations et nos produits sont utilisés, nous ne donnons pas de garantie concernant l'exactitude de cette description ou l'aptitude de nos produits dans certaines situations données. Les utilisateurs de nos produits doivent effectuer leurs propres tests afin de déterminer que chaque produit convient à l'objectif fixé. Par conséquent, le produit en question est vendu sans cette garantie.

Copyright:
INTERFLUX® ELECTRONICS

Consultez la dernière version de ce document sur:

www.interflux.com/fr

Le document dans une autre langue?:

www.interflux.com